

证券代码： 300409

证券简称：道氏技术

广东道氏技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券、招商证券、华创证券、正圆投资、泰禾投资等17家机构，共29位投资者
时间	2026年8月18日（周二） 下午 14:00~17:00
地点	佛山市道氏科技有限公司
上市公司接待人员姓名	潘昀希 董事会秘书 樊正伟 赫曦智算中心 CEO 钟 辉 硅碳项目总经理 袁海龙 碳材料事业部总经理助理 高建锋 IR 总监
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1、赫曦智算中心规模和后续展望。 回复：赫曦智算中心采用芯培森自研 APU 加速技术的赫曦 I 服务器，已完成 100 台部署规模，后续将正式投入运营使用。未来将根据业务发展及市场需求情况，灵活规划、适时推进扩容算力规模。 问题 2、芯培森的发展战略。 回复：芯培森专注于 AI（人工智能）赋能物质研发领域，从事该领域专用算力芯片、加速卡、服务器、集群等计算工具，以及云计算、垂类模型开发、计算方案设计、计算技术培训等计算服务的研发与销售。致力于成为 AI4M 算力底座与材料应用层

解决方案的双重引领者，构建“APU 芯片+ MaterPlato + SwiftMater”三元闭环生态，为材料研发提供一条透明、标准、量化的研发新路径。

问题 3、相对友商，芯培森的优势有哪些。

回复：一是拥有自研 APU 芯片及“赫曦”服务器，算力底座自主可控。APU 芯片专为原子级材料仿真场景深度优化，相比外购通用算力方案，具备更高算力性能与能效优势；二是搭载自研 AI 材料智能体工具 MaterPlato，简化复杂仿真操作流程，降低 AI 材料计算的专业使用门槛，让材料研发人员可以快速上手开展材料计算；三是具备一体化全栈交付能力，依托“赫曦”终端产品，可提供单机服务器、集群到大型算力中心建设运营的完整解决方案。软硬件产品深度协同，一站式交付，更好匹配个人用户、高校、科研单位、企业不同层级算力建设需求。

问题 4、硅碳负极在下游应用中有什么积极的变化？

回复：随着硅碳负极工艺的日渐成熟，单机用量有明显提升，例如在消费电池中，硅碳负极添加量从原来的 10%-15%提升至 30%-40%，在下游应用方面不再局限于消费电池或者无人机电池等方面，在动力电池领域正在逐步导入，有望大幅提升硅碳负极整体的用量。

公司已经具备硅碳负极规模化生产能力，并与客户达成合作，实现批量出货，同时，持续推进下游消费、动力、数码等锂电客户送样验证与导入工作，进一步拓宽市场布局。

问题 5、单壁碳纳米管除了作为锂电池导电剂应用外，还有哪些新方向的应用？

回复：单壁碳纳米管拥有优异的力学、电学和热学性能，伴随产能扩大和成本下降，其在非储能领域拥有较多潜在应用，包

	包括但不限于以下新方向：半导体与碳基芯片中可代替铜线提升热导率、机器人电子皮肤与柔性传感器、医疗与脑机接口用于非侵入式脑电（EEG）信号采集、电磁屏蔽与吸波材料、导电塑料、功能涂料等，前景广阔。 目前，上述方向多处于前沿研发或验证阶段，其规模化应用进程存在不确定性，请投资者注意相关风险。 问题 6、公司 2026 年上半年刚果（金）铜业务情况？ 回复：2026 年上半年，公司刚果（金）铜业务整体经营状况较好，全球铜价整体处于较高水平，叠加阴极铜销量同比上升，为公司业绩作出重要贡献。 风险提示：芯培森为公司的参股公司，公司现持股 20.71%，短期内对公司业绩影响有限。公司持有赫曦原子智算中心 80% 股权。
附件清单(如有)	
日期	2026-08-18